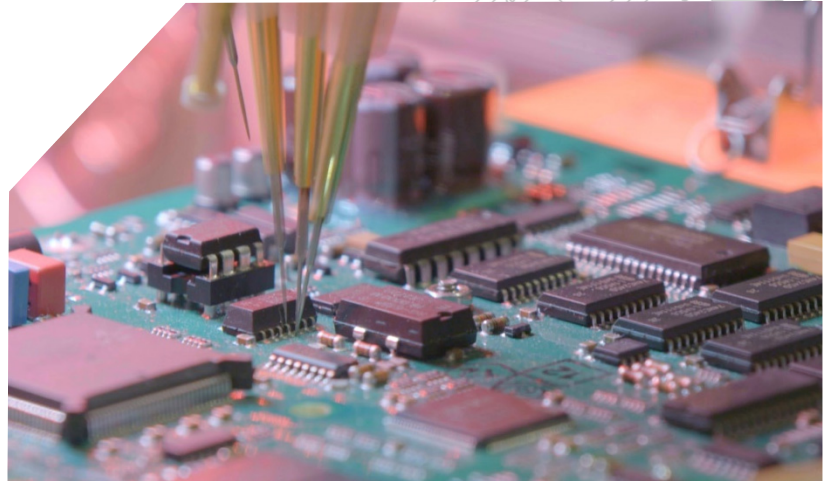


Call for Papers

26. FED-Konferenz
27. und 28. September 2018
Welcome Kongresshotel
Bamberg



Design, Fertigungs- und Managementprozesse für Leiterplatten und elektronische Baugruppen

Präsentieren Sie Ihre Expertise und Erfahrung zu diesen Themen:

More than Moore

- + intelligente Systemintegration
- + QFN-Gehäuse und 01005 SMD-Chips: Anschlussflächen und Prozessierung
- + multifunktionale Leiterplatten: eingebettete Komponenten und integrierte Funktionen
- + 3D von der Leiterplatte bis zur Baugruppe
- + gedruckte Elektronik

PCB-Design: komplexer als Schach

- + Signalintegrität, Power-Integrität und elektromagnetische Interferenzen
- + Power- und Thermo-Management
- + Designrules, Constraints
- + Software-Tools

Design bestimmt Kosten

- + Einflussfaktoren auf Fertigbarkeit und Zuverlässigkeit von Leiterplatte und Baugruppe: Materialauswahl, Dokumentation, Aufbau, Verarbeitung, Prozessschritte
- + Design for AOI/AXI
- + Design for Traceability

Stellschrauben im SMT-Prozess

- + Prozessierung und Einflussfaktoren auf die Zuverlässigkeit
- + Lean Production: Wertstrom, Materialfluss, Losgrößen und Rüstkonzepte

Qualitätsstandards und Umweltaspekte

- + IATF 16949, ISO 9100, ISO 13485, DIN ISO 9001-15
- + Compliance in KMU
- + nachhaltige Elektroniktechnologien

Lieferkette professionell managen

- + Einkaufs- und Beschaffungsprozesse, Bestandsmanagement
- + Produktfreigabe
- + UL-Kennung

Erfolgsfaktor Mensch

- + Motivation, Kommunikation und Führung in Change-Management-Prozessen
- + Zeitmanagement
- + Konfliktlösung
- + Teamarbeit und Projektmanagement mit Scrum

Die FED-Konferenz: bewährte Plattform für die Industrie

Komplex, stabil, nachhaltig und intelligent lautet der Marschbefehl für Elektronikhardware. Diese Leistungen an der Grenze des technisch Machbaren bei gleichzeitiger Zeit- und Kostenersparnis sind nur zuverlässig reproduzierbar, wenn die Prozesse ständig optimiert und automatisiert, aber auch neue Möglichkeiten der Aufbau- und Verbindungstechnik genutzt werden. Zugleich heißt das, dass sich alle an der Entwicklung und Fertigung beteiligten Partner mit- und aufeinander abstimmen müssen.

Die jährlich vom FED veranstaltete Konferenz ist die einzige deutschsprachige Plattform, die den gesamten Entwicklungs- und Fertigungsprozess von elektronischen Baugruppen und Mikrosystemen in der Praxis der beteiligten Unternehmen bearbeitet. Fachvorträge und Expertenrunden zeigen, wie sich die technischen und nicht technischen Prozesse in der Unternehmenspraxis verbessern lassen und welche Potenziale neue Methoden erschließen.

Die FED-Konferenz im Überblick

- + Elektronikhardware: Aufbau- und Verbindungstechnik vom Design bis zum Test
- + bewährte und neue Werkzeuge und Managementsysteme in der Praxis
- + zwei Tage Vorträge und Expertenrunden in vier parallelen Themenblöcken
- + mitreißende Keynote-Vorträge
- + Netzwerken und Entspannen beim Festabend am 27. September
- + Verleihung der PCB Design Awards
- + begleitende Fachausstellung auf 760 m²

Der Nutzen für Sie als Redner

- + Sie präsentieren Ihr Wissen dem Fachpublikum auf der Konferenz und den 700 Mitgliedsfirmen des FED
- + Sie sind am Tag Ihres Vortrages und beim Konferenzabend am 27. September unser Gast
- + Sie bekommen hohe Aufmerksamkeit für Ihr Thema mit unserer Öffentlichkeitsarbeit in Print- und Online-Medien
- + Sie besetzen Ihr Thema in der Konferenzdokumentation des FED

Abstract einreichen bis 13. April 2018 · konferenz@fed.de

Schicken Sie uns bitte Ihr Angebot für einen Fachvortrag mit einer Vortragslänge von 35 Minuten mit der Angabe des **Themas Ihres Vortrages und eine Zusammenfassung des Inhalts** (Abstract) per E-Mail an konferenz@fed.de

Die Konferenzsprache ist deutsch. Über die Zulassung des Vortrages entscheidet unser Konferenzkomitee.

Ihre Ansprechpartner



Claudia Mallok
Mitglied im FED-Fachbeirat

Tel. +49(0)34466 713221



René Kluge-Fiedler
Projektmanager
Technologietransfer

Tel. +49(0)30 340 6030-59